

Information Meeting 2013 Q&A

Q: オールインワンモジュール戦略について採用の課題と収益面について教えてください。

A: 採用については当社の拡売戦略だけで決まるわけではなく、各社の設計コンセプトによる部分も大きいです。ただしスマートフォンの実装面積はタイトになる方向に進んでおり、ニーズは出てくるものと考えています。収益面についても SAW デバイス、PA など自社生産部品を使用するため付加価値は獲得できると考えています。

Q: 自動車市場向けについての課題を教えてください。

A: 現在は MLCC、MEMS センサ、発振子、Wi-Fi モジュール、電源などが主力製品です。今後は ISS 車や EV 車が伸びパワーエレクトロニクス向けの需要が増えることからこれらの分野にも注力していきたいと考えています。

Q: 下期の受注の動きについて想定と比べてどのように見えていますか。

A: 11 月の受注は 10 月に比べて減少していますが、既に発表している業績予想の見通しから変更はありません。

Q: 株主還元について教えてください。

A: 1 株当たり純利益を上げて安定的に配当を増やしていくという従来からの方針に変更はありません。自社株買いについては株価を見ながら中長期的な株主還元として考えています。

Q: 通信端末のフロントエンドモジュールのトレンドについて教えてください。

A: LTE 端末の拡大に伴うバンド数の増加で、デュプレクサを内包したフロントエンドモジュールが増加するとみえています。

Q: 異種コンデンサの置き換えについて教えてください。

A: 携帯端末、PC などではタンタルコンデンサからの置き換えを進めています。

Q: 車載用 MLCC についてどの分野を伸ばしていくのか教えてください。

A: 高温保証、フェールセーフに対応した製品を拡売していきます。

Q: PA を含むモジュールの戦略について教えてください。

A: 当社の強みは SAW デバイス、LTCC 技術など多くのキーコンポーネントを内部に保有することで多様なマッチングのパターンが可能なこと。この強みを生かしていきたいと考えています。

Q: 海外への生産シフトについて教えてください。

A: 今期末の海外生産比率は 27%を計画しており、今後も増加していくことになると思いますが、直ちに 50%を超えていくということにならないだろうと考えています。海外生産は今後も増やしていきますが、付加価値の高い新商品を国内で開発し、国内で早期に立ち上げることに注力していきたいと考えています。

当 Q & Aに記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。

(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当 Q & Aに記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。